

第91回マイクロ接合研究委員会 プログラム

日 時：平成 21 年 9 月 4 日(金) 10:30～16:30

場 所：自動車会館（東京 市ヶ谷）

	時 間	題 目	講 演 者
平成 21 年 9 月 4 日 (金)	司 会 久保雅男 (パナソニック電工(株))		
	10:30～11:15	『Sn の同素変態の特徴』	芝浦工業大学 ○荻谷義治 芝浦工業大学大学院学生 関 景樹
	11:15～12:00	『はんだ実装における評価技術とその事例』	(株)クオルテック ○高橋政典
	12:00～13:00	昼 食 休 憩	
	13:00～13:10	委 員 会 議 事	
	司 会 石塚直美 (日本電気(株))		
	13:10～13:55	『導電性接着剤実装部の耐湿加速試験』	エスベック(株) ○田中浩和、平田拓哉
	13:55～14:40	『Sn めっき付 Cu 板へのCu 超音波接続の検討(仮)』	(株)日立製作所 生産技術研究所 ○藤原伸一 StanfordUniversity Reinhold.H.Dauskardt
	14:40～15:00	休 憩	
	司 会 阪元智朗 (オムロン(株))		
	15:00～15:45	『無電解 Ni-P/Au めっき上の Sn-Ag-Cu-Ni BGA ボール接合部耐衝撃性に関する研究』	NECエレクトロニクス(株) ○川城史義、柳瀬一 氏家正人、衛藤敬基 千住金属工業(株) 岡田弘史
	15:45～16:30	『酸化銀粒子を用いた酸化物との接合』	(株)日立製作所 材料研究所 ○守田俊章、保田雄亮 井出英一 大阪大学 廣瀬明夫

※プログラムは都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。